

加工可能一覧表

【製作可能仕様】

一般FPC

・ベース材	接着材有りタイプ (ニッカン・有沢・東レ・TAIFLEX) 無接着材タイプ (新日鐵・宇部・パナソニック・SD FLEX・TorayDupont)	ポリイミド25、12.5(μm) 銅箔(電解、圧延、特殊電解)35、18(μm) ポリイミド25、12.5、50(μm) 銅箔圧延)35、18 (電解)18、12、9、6、5、2(μm)
・カバー材	エポキシ系接着材タイプ (ニッカン・有沢・INNOX・TorayDupont) ポリイミド系インク インクレジスト 液状レジスト 感光性カバーレイ	ポリイミド25、12.5(μm) 感光性タイプ(10~25 μm) 熱硬化タイプ(10~20 μm) 感光性タイプ(10~25 μm) アクリル樹脂(50 μm)
・表面処理	半田メッキ NiAuメッキ 防錆処理 複合メッキ	鉛フリー(すず:銅=99:1) ◇以下の鉛入りメッキもご対応させていただきます。 有機酸(すず:鉛=6:4)、ホウフッ化、9:1(すず:鉛) 電解(無電解)フラッシュ、ボンディング、直金 水溶性プリフラックス、耐熱防錆処理 半田+金、金+防錆、金+半田+予備半田
・両面テープ	粘着タイプ(デクセリアルズ、3M、日東電工など) 熱硬化タイプ(ニッカン工業、有沢製作所)	
・ACF	日立化成、デクセリアルズ	
・補強フィルム	ポリイミド、白色ポリエステル	※厚みはご相談下さい。
・補強板	ガラスエポキシ、コンポジット、紙フェノール、アルミ、SUS	※厚みはご相談下さい。
・シルク印刷	白色、つや消し黒色	
・シールド仕様	銅ペースト印刷、銀シールドフィルム 銀ペースト印刷	
・部品実装	手付け、リフロー、鉛フリー対応可	※部品調達も行っております。

特殊構造FPC ※下記仕様につきましては、弊社営業担当者にご相談下さい。

・ファインピッチFPC	参考限界値)片面 30 μm ピッチ/両面 60 μm ピッチ 一般品) 片面 40 μm ピッチ/両面 70 μm ピッチ
・片面/両面プリパンチFPC	
・多層FPC(3~6層)	オールポリイミド、貫通スルホールタイプ
・バンプメッキ付FPC	材質)Cu+Ni-Au、アスペクト比 1:1
・小径ビアFPC	最小穴径 ϕ 0.05、最小ランド径 ϕ 0.25
・ブラインドビアFPC	最小穴径 ϕ 0.08、最小ランド径 ϕ 0.3
・部分スルホールメッキFPC	最小穴径 ϕ 0.3、最小ランド径 ϕ 0.6 最小部分メッキ径 ϕ 0.6
ベアチップ実装	最小ピッチ 38 μm ACF圧着
ACF圧着加工(試作対応)	FPC+FPC、TCP、各種パネル類、硬質基板 他
アディティブ品	・アディティブファインピッチFPC 最小ピッチ 20 μm
硬質基板	片面~16層まで対応。 その他、IVH多層基板、アルミコア基板対応。

【量産対応】

※特殊構造FPCは、量産品のご対応ができない場合がございます。
 ※アディティブ品は、量産品のご対応ができませんので、ご了承ください。